

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

# 联芸科技（杭州）股份有限公司

（浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室）



## 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二六年四月

## 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

## 重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过，并经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积

金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 10%，即不超过 46,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权、中国证监会及上交所相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

5、本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所等有关规定执行。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 206,167.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
<b>1</b>	<b>面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目</b>	<b>214,500.96</b>	<b>166,167.60</b>
1.1	企业级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	44,403.40	44,403.40
1.2	企业级 PCIe Gen7 SSD 主控芯片	89,820.06	41,486.70
1.3	消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	46,135.32	46,135.32
1.4	UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片	34,142.19	34,142.19
<b>2</b>	<b>补充流动资金</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>254,500.96</b>	<b>206,167.60</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

7、本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

8、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司进一步完善了股利分配政策，关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国

证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并起草了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，详情参见本预案“第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺”，请投资者予以关注。

公司所制定的填补被摊薄即期回报措施不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成盈利预测和承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关风险说明”有关内容，注意投资风险。

## 目 录

公司声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目 录 .....	7
释 义 .....	9
<b>第一节 本次向特定对象发行股票概要 .....</b>	<b>11</b>
一、发行人基本情况 .....	11
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 .....	11
三、发行对象及其与公司的关系 .....	14
四、本次发行方案概要 .....	15
五、本次发行是否构成关联交易 .....	18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....	19
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 .....	19
八、本次发行方案已取得的批准及尚需呈报的批准程序 .....	19
<b>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b>	<b>20</b>
一、本次发行募集资金使用计划 .....	20
二、本次募集资金投资项目的的基本情况 .....	20
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....	29
四、本次募集资金投向属于科技创新领域 .....	30
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>32</b>
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况 .....	32
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....	33
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....	33
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .....	34
五、本次发行对公司负债情况的影响 .....	34

六、本次股票发行相关风险说明 .....	34
<b>第四节 公司利润分配政策及执行情况 .....</b>	<b>39</b>
一、公司利润分配政策 .....	39
二、公司最近三年股利分配情况 .....	42
三、公司最近三年未分配利润使用安排情况 .....	42
四、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 .....	42
<b>第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 .....</b>	<b>47</b>
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 .....	47
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 .....	49
三、本次发行的必要性和合理性 .....	50
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 .....	50
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 .....	52
六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 .....	54

## 释 义

在本预案中，若无特殊说明，下列词语具有以下特定含义：

一、普通术语		
联芸科技、发行人、公司	指	联芸科技（杭州）股份有限公司
本预案、发行方案	指	联芸科技（杭州）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	联芸科技（杭州）股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
A 股	指	经中国证监会审批向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币 1.00 元的普通股
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
股东会	指	联芸科技（杭州）股份有限公司股东会
董事会	指	联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
《分红回报规划》	指	《联芸科技（杭州）股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
二、专业术语		
AIoT	指	人工智能物联网
PC	指	电脑
SoC	指	System on Chip，即系统级芯片，指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件，如手机 SoC 集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
SSD	指	固态硬盘
Fabless 模式	指	无晶圆生产线集成电路设计模式
IP	指	芯片中具有独立功能的电路模块设计

SATA	指	一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口
PCIe	指	一种高速串行计算机扩展总线标准
DDR	指	双倍速率同步动态随机存储器
CPU	指	中央处理器，是计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
NAND Flash	指	存储晶圆经过切割、萃取工艺后得到的单颗存储芯片
GB/s	指	吉字节每秒，衡量数据传输速度/带宽的单位
GT/s	指	吉传输每秒，指总线每秒钟能完成的数据传输次数，用来衡量 PCIe、CXL 等高速接口的物理速率
晶圆	指	硅半导体集成电路所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆
流片	指	Tape Out，在完成芯片设计后，将设计数据提交给晶圆厂生产
封装	指	将芯片装配为最终产品的过程，即把芯片制造厂商生产出来的芯片放在一块起承载作用的基板上，引出管脚，固定并包装成一个整体
测试	指	使用专用的自动测试设备检查制造出来的芯片功能和性能
NVMe	指	Non Volatile Memory Host Controller Interface Specification Express，即非易失性内存主机控制器接口规范
IOPS	指	Input/Output Operations Per Second，计算机存储设备性能的量测方式，可视为每秒的读写次数
ECC	指	Error Correcting Code，是一种能够实现“错误检查和纠正”的技术
QoS	指	Quality of Service，指一个网络能够利用各种基础技术，为指定的网络通信提供更好的服务能力，是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术
UFS	指	Universal Flash Storage，通用闪存存储，是一种内嵌式存储器的标准规格和符合该标准的存储产品
CXL	指	Compute Express Link，是一种高速、低延迟、基于缓存一致性的互联协议，能让 CPU、GPU、内存和存储高效互联互通、共享内存资源
OPAL	指	让硬盘自带硬件加密引擎、数据自动加解密、防盗窃与非法访问的存储安全标准
存算一体	指	在存储中执行计算，减少数据迁移，实现高算力、低延迟、低功耗的新型计算架构
OCP	指	开放计算项目，是一套面向数据中心的开放硬件标准，通过标准化、模块化设计提升服务器、存储与算力的通用性与能效，为大规模算力基础设施提供开放兼容的底层架构

注：本预案除特别说明外，数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

## 第一节 本次向特定对象发行股票概要

### 一、发行人基本情况

公司名称	联芸科技（杭州）股份有限公司
英文名称	Maxio Technology (Hangzhou) Co., Ltd
成立时间	2014 年 11 月 7 日
法定代表人	李国阳
注册资本	460,000,000 元
总股本	460,000,000 股
股票上市地	上海证券交易所
上市板块	科创板
股票简称	联芸科技
股票代码	688449
上市时间	2024 年 11 月 29 日
公司住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室
邮政编码	310059
电话号码	0571-85892516
传真号码	0571-85892517
公司网址	www.maxio-tech.com
电子邮箱	ir@maxio-tech.com
经营范围	技术开发、技术服务、成果转让：集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

### 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

#### （一）本次向特定对象发行股票的背景

##### 1、国家政策鼓励数据存储行业高质量发展

数据存储产业是数字经济与智能技术发展的核心底层支撑。海量多模态数据的生成、训练与应用，让存储从基础配套升级为关键算力基础设施，直接决定模

型效率与数字化转型速度，同时保障数据安全与产业自主可控，是国家科技竞争和数字安全的重要战略基石。

近年来，国家出台一系列产业政策，支持数据存储相关产业发展。2024 年 5 月，工信部等多部门联合发布《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》，提出“建设‘算、存、运’一体化算力基础设施标准体系”、“开展算力接入、调度、服务等相关标准研制”、“着力加速新型存储芯片关键技术标准研制”。2025 年 5 月，工信部印发《算力互联互通行动计划》，提出“提升数据与存储互通能力。推动全局文件系统、智能分层存储、数据压缩与去重等存储技术应用，提升海量非结构化数据的高效承载水平”。2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出“做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器”、“推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用”。国家多层次、全方位的政策支持为数据存储行业营造了优良发展生态，促进相关企业提高技术创新水平，助力我国数据存储行业实现高质量发展。

## 2、人工智能资本支出激增重塑存储产业格局

全球企业对人工智能技术的投入持续加大，大模型训练、推理及各行业智能化落地场景不断拓展，对存储硬件的需求随之显著增加。海量的数据处理需求，对存储硬件的容量、读写效率提出了更高要求，直接带动存储硬件采购需求攀升，成为存储市场需求增长的核心动力。Gartner 预测，2026 年全球人工智能支出将突破 2.52 万亿美元，其中 AI 基础设施支出将新增 4,010 亿美元，涵盖存储设备等核心领域。

AI 时代的需求升级，不仅带来存储需求量的激增，更深刻重塑了全球存储产业的整体结构。过往存储产业布局以消费电子、通用办公等场景为主，需求呈现分散化、同质化特征，而当前 AI 场景已成为驱动存储产业发展的核心引擎，产业资源与布局重心逐步向 AI 适配型存储产品倾斜。随着应用场景的不断细分，行业需求呈现出鲜明的差异化、专业化特征，云端大模型部署需依托大容量、高

稳定性、高并发的企业级闪存存储产品，端侧设备则对存储的小型化、低功耗、高适配性提出明确要求，这种需求分化倒逼存储厂商优化产品矩阵，聚焦 AI 场景的定制化研发，推动产品向场景化、专业化升级。

与此同时，人工智能产业对数据安全、传输效率、协同适配的高要求，进一步倒逼存储产业加速升级，推动存储技术与云计算、大数据等新一代信息技术深度融合，构建起更加完善的产业生态。随着 AI 技术向金融、医疗、智能制造、自动驾驶等重点领域深度渗透，各行业应用场景的落地持续释放闪存存储增量需求，带动闪存存储产业链上下游协同升级，从核心芯片研发、终端产品制造到场景化应用部署，均需开展优化调整。原本分散化的产业格局逐步向 AI 场景聚焦，形成以 AI 需求为核心、上下游协同联动的新型存储产业结构，推动存储产业实现从“容量竞争”向“场景适配、效率优先、生态协同”的转型，为下游产业的持续发展提供坚实支撑。

## （二）本次向特定对象发行股票的目的

### 1、抢抓 AI 算力变革机遇，实现存储主控向存算一体升级

AI 算力基础设施的爆发式演进，正推动 SSD 主控芯片从传统存储控制器向 AI 推理的 IO 算力枢纽全面升级。面向 AI PC 普及、端侧设备爆发与数据中心高速发展的行业趋势，公司将紧抓行业变革机遇，率先布局新一代 SSD 主控与嵌入式存储主控技术，以芯片全新架构与 CXL 互联生态为双引擎，全面覆盖消费级、嵌入式与企业级存储场景，加速切入 AI 存储核心赛道，为大模型训练、云端推理、智能终端及车载等场景打造高性能、低时延、高可靠的存储算力底座，完成从存储主控供应商向存算一体核心芯片厂商的战略升级。

### 2、双轮驱动消费级与企业级，打开 AI 时代存储增长空间

#### （1）消费级+嵌入式：紧抓端侧 AI 机遇，巩固现有市场地位

AI PC 正迎来快速渗透，预计 2026 年渗透率将达到 55%。终端对本地大模型加载、高清视频处理等场景的存储性能提出更高带宽需求，PCIe Gen6 SSD 主

控成为未来技术演进的主流方向。同时 UFS 5.0 作为新一代移动及嵌入式存储标准，可承接 AI 手机、车载系统等端侧设备升级需求。

公司目前已在消费级 SSD 主控芯片市场中占据优势地位，在零售消费渠道和 PC-OEM 市场均实现大规模出货；在嵌入式主控芯片市场取得突破进展，UFS 3.1 主控芯片成为客户 B 唯一本土供应商，在终端手机厂商导入顺利，今年将批量出货。

公司将依托现有消费级客户渠道与技术积累，快速导入 PCIe Gen6 SSD 主控与 UFS 5.0 嵌入式主控芯片，实现 UFS 2.2/3.1/4.1/5.0 全场景覆盖，进一步提升市场份额，赋能消费终端存储升级与智能化发展。

#### （2）企业级高端市场：切入数据中心，构建长期增长新动能

数据中心爆发式增长，单台服务器存储需求为传统服务器 8-10 倍，PCIe Gen6/Gen7 主控凭借高带宽、高并发、高能效成为核心刚需。

公司目前已完成企业级主控技术的布局，企业级 PCIe Gen5 SSD 主控芯片已进入量产测试阶段，并被客户 B 选用。公司将以现有市场地位和技术积累为基础，向企业级 PCIe Gen6&Gen7 SSD 主控升级，打造高端企业级存储解决方案，突破云厂商与服务器厂商认证壁垒，全面切入企业级存储与算力基础设施供应链，打开全新增长曲线，提升全球竞争力，对冲消费电子周期波动，构建长期可持续增长动能。

### 三、发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象及其与公司的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

#### 四、本次发行方案概要

##### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

##### （二）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。

##### （三）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有

规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

#### （四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$  为调整前的发行底价， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送股或转增股本数， $P_1$  为调整后的发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

#### （五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不

超过本次发行前公司总股本的 10%，即不超过 46,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权、中国证监会及上交所相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

#### （六）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所等有关规定执行。

#### （七）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 206,167.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目	214,500.96	166,167.60
1.1	企业级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	44,403.40	44,403.40
1.2	企业级 PCIe Gen7 SSD 主控芯片	89,820.06	41,486.70
1.3	消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	46,135.32	46,135.32

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1.4	UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片	34,142.19	34,142.19
2	补充流动资金	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>合计</b>		<b>254,500.96</b>	<b>206,167.60</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

#### （八）本次发行前滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

#### （九）股票上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上交所科创板上市交易。

#### （十）本次发行决议的有效期限

本次向特定对象发行股票相关决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

### 五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

## 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，截至本预案公告日，公司无控股股东，方小玲女士合计控制公司 35.39%的股份，为公司实际控制人。

本次向特定对象拟发行股票总数不超过发行前股本的 10%。假设按照上述发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司实际控制人的控制地位未发生变化。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 八、本次发行方案已取得的批准及尚需呈报的批准程序

本次向特定对象发行的方案及相关事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需履行以下审批程序：

- 1、公司股东会审议通过；
- 2、上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 206,167.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
<b>1</b>	<b>面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目</b>	<b>214,500.96</b>	<b>166,167.60</b>
1.1	企业级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	44,403.40	44,403.40
1.2	企业级 PCIe Gen7 SSD 主控芯片	89,820.06	41,486.70
1.3	消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片	46,135.32	46,135.32
1.4	UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片	34,142.19	34,142.19
<b>2</b>	<b>补充流动资金</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
	<b>合计</b>	<b>254,500.96</b>	<b>206,167.60</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

### 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目基本情况

##### 1、项目基本情况

本项目总投资为 214,500.96 万元，建设期为 5 年，项目将依托公司现有场地及成熟的研发基础，购置研发软硬件设备，推动高端存储主控芯片核心技术研发与创新。项目具体将围绕企业级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片、企业级 PCIe Gen7 SSD

主控芯片、消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片、UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片等展开技术攻关，重点突破超高速接口设计、高效能闪存管理、低功耗优化等关键技术难题。研发成果将精准匹配智能终端、数据中心等场景对存储性能、带宽、可靠性的高端需求，进一步完善公司高端产品矩阵，强化核心技术自主可控能力，助力国产高端存储产业升级，为公司持续抢占市场竞争制高点奠定坚实基础。

## 2、项目实施的必要性分析

### （1）人工智能资本支出激增重塑存储产业格局，数据存储主控芯片重要性提升

当前，全球半导体产业正经历由生成式人工智能驱动的模式转移，算力基础设施的爆发式建设直接引爆了存储行业的结构性周期。据 CFM 闪存市场数据统计，微软、谷歌、亚马逊和 Meta 将 2025 年的资本支出上调至合计约 4,000 亿美元，预计 2026 年资本支出将增长 25% 至约 5,000 亿美元，Oracle、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius 等新云厂商正在快速崛起，与 OpenAI、英伟达和微软等科技巨头形成战略合作，以翻倍增长的资本支出投入 AI 基础设施建设。国内以阿里、腾讯为代表的互联网企业也在坚定 AI 长期发展战略。阿里计划投入超过 3,800 亿元人民币，用于建设云和硬件基础设施。腾讯明确“2025 年资本开支仍将高于 2024 年”，持续加大相关投入，这种史无前例的资本注入已转化为对存储硬件的指数级需求。

在云端数据中心侧，CFM 预测 2026 年北美云服务提供商（CSP）的 NAND Flash 需求将同比激增 265%，Gartner 数据指出 2025 年全球 AI 服务器出货量将达 234.9 万台（同比增长 39.1%），单台服务器的存储容量需求是传统服务器的 8-10 倍，对高带宽、低延迟的企业级 SSD 提出海量需求。

在终端消费电子侧，AI 浪潮正从云端向端侧全面渗透，根据 IDC 和 Gartner 数据，2026 年 AI 手机与 AI PC 的市场渗透率预计将分别突破 53% 与 55%，大模型本地推理（如 7B/13B 参数模型）对存储容量（1TB-8TB 区间）及带宽提出了前所未有的严苛要求，推动智能手机和 PC 迎来结构性升级。

长远来看，AI 时代的到来，正在彻底重构全球存储产业的格局。过去，存储只是算力系统的配套配件；而现在，存储已经成为决定算力上限的核心战略资源和制约产业扩张的核心瓶颈。面对由“云端智算”与“端侧推理”双轮驱动的“量价齐升”结构性爆发，数据存储主控芯片作为数据交互的核心枢纽，正处于战略机遇窗口期，快速响应并适配这一指数级增长的需求，是企业确立未来十年生态位的关键。

## **（2）国外存储厂商具备先发优势，本土存储厂商需在产品研发、生态协同方面加以完善，以提升 AI 场景落地效率**

在人工智能高速发展的冲击下，全球存储产业竞争重心快速向高带宽、低延迟、大容量、高可靠性的 AI 专用存储转移。在此背景下，NAND Flash 市场的增长引擎已经完成切换，根据 CFM 闪存市场数据，2026 年下游应用场景中，服务器端的占比已从过去的 20%+ 飙升至 37%，成为应用最大的领域，并有持续增长的趋势。这一结构性的转变背后，是 AI 对存储架构的重塑，针对 AI 推理优化的企业级 SSD 需求正快速攀升。

目前我国固态存储产业虽已实现从无到有的突破，并在中低端消费级市场实现替代，但在企业级市场和高端消费级市场仍有较大的提升空间。以企业级 SSD 为例，根据 TrendForce(集邦咨询)2025 年全年统计，三星、SK 海力士(含 Solidigm)、美光、铠侠和闪迪等合计占据全球企业级 SSD 市场 90% 以上的份额，海外企业占据主导地位，国内厂商市场份额较低。因此，国内存储产业链急需在产品研发、生态协同等方面加以完善，提升场景落地效率。

在核心产品研发层面，国内存储厂商需重点研发面向大模型与数据中心的高带宽、大容量、高可靠性存储芯片，兼顾低延迟与高吞吐，支撑 AI 训练推理与海量数据存储需求；国内存储主控芯片厂商则需研发高端企业级主控芯片、高端消费级主控芯片，集成 AI 加速、智能纠错、功耗优化与安全加密能力，兼容 PCIe Gen6、PCIe Gen7 与 CXL 等新一代接口，实现高带宽读写与多盘并发管理，为服务器、边缘智能设备提供稳定高效的存储控制方案，实现存算一体功能。

固件与算法层面，国内厂商需针对性研发适配不同应用场景的专用固件，优化存储性能与使用寿命，强化固件的稳定性和适配性；加大核心算法自主研发力度，通过技术创新完善存储管理、数据处理等相关能力，结合国产存储硬件特性优化升级，提升存储系统的运行效率与可靠性，同时探索新型架构创新，推动存储与计算的协同发力，更好适配应用场景的高效运行需求。

系统适配层面，海外存储产品与 NVIDIA、AMD 等主流 GPU 芯片、云平台、AI 框架深度绑定，生态认证完善、兼容性强。国内存储产业链需强化协同创新，加强与算力硬件、云服务等相关领域的深度合作，推动存储系统与各类人工智能相关技术、平台的高效适配，充分释放算力价值；推进存储领域标准建设与推广，构建统一开放的适配体系，打通端边云全场景适配链路；升级分布式存储架构，提升海量数据存储、调度能力，增强系统的扩展性与稳定性，满足规模化、多元化的存储应用需求。

### **(3) 人工智能技术和应用普及，促进对数据存储主控芯片的技术迭代需求**

高性能计算，特别是人工智能技术和应用的普及，带来了对存储带宽和容量的极限需求。当内存容量无法满足 GPU 的需求时，外部存储成为最优的补充方案。

目前数据中心所采用的 PCIe Gen5 存储主控 (PCIe Gen5x4 理论带宽 16GB/s) 在应对多租户下的训练和推理需求时仍有不足，未来将被 PCIe Gen6 存储主控 (PCIe Gen6x4 理论带宽 32GB/s) 甚至更高速率的 PCIe Gen7 存储主控 (PCIe Gen7x4 理论带宽 64GB/s) 逐步替代。未来企业级 SSD 主控芯片将以更高的带宽来满足超算中心，AI 训练集群的 PB 级数据的并行读写。

随着推理的应用逐渐从云端下放到端侧，AI-PC、AI 手机以及车载系统对存储的带宽需求也在爆发式增长。目前高性能 PC 已经普及了消费级 PCIe Gen5 存储主控，在推理需求的推动下，也会快速往 PCIe Gen6 存储主控演进。而高端手机同样也会以 UFS 5.0 嵌入式主控 (双通道理论带宽 11.6GB/s) 来替代目前已经普及的 UFS 4.0 嵌入式主控 (双通道理论带宽 5.8GB/s)。

主控芯片需适配下一代高速接口协议，实现更高的传输效率（优化编码方式）、更高的带宽（翻倍）、更优的能效以及与智能终端设备、存储介质的更高效兼容。消费级场景需支持 PCIe Gen6 协议，云端场景需支持 PCIe Gen7 协议，嵌入式场景需支持 UFS 5.0 协议，同时需兼容 DDR5、HBM 等新一代存储介质，确保存储系统的整体性能释放。

公司本项目聚焦高端产品研发方向，精准匹配存储技术迭代趋势和市场需求痛点。企业级 PCIe Gen6 与 Gen7 SSD 主控芯片能够适配数据中心的海量数据处理场景，消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片可满足端侧 AI 计算的高速存储需求，UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片则契合高端移动终端的性能升级需求。通过本项目实施，公司将有效填补现有产品在超高速传输、AI 场景适配等领域的性能差距，抢抓存储接口协议迭代与产业升级窗口期，面向下游终端客户打造高性能、高可靠的存储解决方案，深度契合下游产业发展与下一代存储技术演进趋势，全面打开成长空间。

#### **（4）市场竞争加剧的背景下，本次募投项目具有紧迫性与必要性**

当前，存储主控芯片领域的技术竞赛正面临时间窗口的急剧收窄，在人工智能技术的强力驱动下，硬件迭代周期已经大幅压缩。同时，企业级存储产品进入头部互联网企业以及运营商等核心云服务商供应链，需经历长达 6-12 个月的严苛可靠性验证与兼容性测试，认证周期较长。因此，公司急需在未来几年内实现企业级 PCIe Gen6/Gen7 SSD 主控芯片、消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片以及 UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片的规模化量产并完成核心客户的导入，抢抓未来服务器与终端设备市场爆发式增长黄金窗口。

目前存储行业竞争呈现白热化态势，国际巨头凭借技术积累和产能优势持续抢占高端市场，国内外独立主控厂商已在下一代技术架构上进行了前瞻性布局，国内同行也在加速推进产品升级和场景拓展。尽管公司已占据全球独立第三方 SSD 主控出货量第二、国内第一的领先地位，在消费级存储主控领域取得显著成功，并在企业级存储主控领域取得研发突破。但随着消费终端、数据中心等场景

的需求持续扩张，客户对存储产品的性能和适配性要求不断提高，公司需要及时跟进技术迭代和产品升级以维持现有优势地位并进一步拓展产品下游应用。

本项目的实施将进一步完善公司全栈数据存储主控芯片产品布局。通过拓展企业级 PCIe Gen6 与 Gen7 系列 SSD 主控芯片产品，公司可切入数据中心、智算中心等高附加值市场；通过拓展消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片和 UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片，公司则能强化在高端移动终端市场的竞争力。多样化的产品组合将使公司能够在消费终端和企业云端两大领域，进一步提升客户粘性和市场占有率。同时，项目带来的技术积累和产能储备将构筑公司核心竞争壁垒，增强公司应对市场波动的能力，巩固公司在数据存储主控芯片领域的领先行业地位，为长期可持续发展奠定坚实基础。

### 3、项目实施的可行性分析

#### (1) 国家政策支持集成电路产业和数据存储领域的关键技术发展

集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。政府自 2000 年以来将集成电路行业确定为国民经济支柱性行业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的产业政策，支持集成电路相关的税收减免、研发创新、人才引用、市场应用等方面，推动了行业的迅速发展。《“十五五”规划纲要》明确提出“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路……等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。

数据存储是数字经济与人工智能发展的核心底座和基础设施，其容量、速度与稳定性直接决定大模型训练、推理及数据价值释放的上限，支撑数字经济、智能制造等全领域运转。《“十五五”规划纲要》明确提出“发展高性能处理器和高密度存储器……推进存算一体、三维集成、光电融合等技术突破应用”。作为数据调度的“大脑”，数据存储主控芯片已经升级为决定 AI 推理效能、实现存算一体的核心引擎。在国家产业政策持续支持背景下，本项目围绕高端数据存储主控芯片关键技术开展研发，符合国家产业发展方向与技术发展趋势，具备良好

的政策环境与实施基础。

## （2）健全的研发平台与深厚的技术积累为项目提供坚实基础

公司自成立以来，一直注重研发平台的建设和核心技术的积累，经过数年的发展和技术耕耘，已构建起涵盖 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。同时公司在过往消费级 PCIe Gen3-Gen5 SSD 主控芯片、企业级 PCIe Gen5 SSD 主控芯片、UFS 3.1 主控芯片等产品的研发中具备丰富经验，在数据存储主控芯片的通用 IP、专用技术、芯片设计量产等关键领域积累了多项核心技术。公司将持续对数据存储主控芯片设计相关的核心技术进行优化，不断加大芯片产品研发的投入力度，提高和完善产品性能、技术水平。

公司拥有一支高素质的设计研发人才队伍，截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发团队规模超过 600 人，公司研发人员占总员工比例达到 83.74%，具备并行开发多款数据存储主控芯片的能力。

在消费级 PCIe Gen6 SSD 主控芯片和 UFS 5.0 嵌入式存储主控芯片方面，本次募投产品是在现有产品下的代际升级，公司已实现消费级 PCIe Gen5 SSD 主控规模量产出货，嵌入式 UFS 3.1 主控芯片已导入客户 B 且为其唯一本土供应商，目前在终端手机厂商测试顺利，今年将批量出货，公司具备成功研发量产经验以及研发技术储备，且在消费电子端应用市场得到反复验证，技术可行性可得到充分保障。

而在企业级 PCIe SSD 主控芯片研发方面，公司企业级 PCIe Gen5 SSD 主控芯片已进入量产测试阶段，并被客户 B 选用。这一突破标志着公司在全面掌握消费级存储主控技术的基础上，已完成企业级主控技术的布局，为下一代企业级 PCIe Gen6、PCIe Gen7 SSD 主控芯片研发提供了坚实支撑。基于消费级 PCIe Gen5 主控的技术底座，公司完成了多维度企业级存储主控技术的升级，既保留高性能、低功耗优势，又适配企业级场景的严苛需求。

公司已构建完整的技术储备，下一代企业级 PCIe Gen6/PCIe Gen7 SSD 主控

芯片、消费级 PCIe Gen6 主控芯片和 UFS 5.0 嵌入式主控芯片研发路径清晰、可行性充分，可顺利实现研发与量产。

### （3）领先的市场地位和丰富的客户资源为项目顺利落地提供有利支撑

公司目前已占据全球独立第三方 SSD 主控出货量第二、国内第一的领先地位，在消费级存储主控领域取得显著成功，产品线实现 SATA 到 PCIe Gen3-Gen5 全代际覆盖，PCIe Gen5 SSD 主控已规模出货。同时，公司在嵌入式存储领域已完成 UFS 相关技术布局，嵌入式 UFS 3.1 主控芯片已导入客户 B 且为其唯一本土供应商，目前在终端手机厂商测试顺利，今年将批量出货，为后续 UFS 全系列迭代打下坚实基础。凭借自研 Agile ECC、NAND 自适应等核心技术，公司与产业链上下游核心伙伴深度协同，产品已进入全球主流品牌 PC 供应链，规模效应与客户生态稳固了消费级市场龙头地位。

同时，公司在企业级市场已实现 SATA 主控芯片年出货量达百万颗规模，企业级 PCIe Gen5 SSD 主控芯片也已进入量产测试阶段，并被客户 B 选用，为向更高阶企业级市场延伸奠定坚实基础。

经过多年技术积累与品牌沉淀，公司已进入客户 A、江波龙、客户 B、佰维存储、德明利、时创意、怡亚通、威刚等行业头部客户的供应链体系，并成为其在上述领域的主要供应商。公司本次募投项目的下游客户与公司原有产品下游客户高度重合。

## 4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为联芸科技（杭州）股份有限公司，总投资为 214,500.96 万元，拟使用募集资金 166,167.60 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	设备购置费	23,593.28	10,184.94
2	研发人员薪酬费用	83,418.90	70,851.90
3	流片费用	67,922.95	61,848.07

序号	项目	拟投资总额	拟使用募集资金金额
4	项目实施费用	39,565.83	23,282.69
合计		<b>214,500.96</b>	<b>166,167.60</b>

## 5、项目用地、涉及的审批、备案事项

本项目实施地点位于浙江省杭州市，拟使用联芸科技的现有办公场所，不涉及新增土地用地审批手续。

截至本预案公告日，本项目的备案手续尚在办理过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

### （二）补充流动资金

#### 1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 40,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展对营运资金的需求，优化资本结构，保障公司主营业务持续稳健发展。

#### 2、项目实施的必要性分析

##### （1）芯片设计行业特征决定公司需要充足的资金保障

公司所处的芯片设计行业属于典型的资金、技术、人才密集型行业，行业经营特点与发展模式决定了企业的晶圆采购、周转，芯片研发、投产，人才招聘和培养，均需要大量资金投入等方面均需要大量的资金投入。此外，芯片设计是半导体产业链中的核心环节之一，需要大量的研发投入以保持技术领先。随着芯片性能和工艺制程的不断发展，数据存储主控芯片外购接口协议 IP、晶圆厂流片所需的资金需求也将不断增加，公司需要不断加大研发投入用于技术研发。

本次补充流动资金将有利于保障公司业务规模的拓展、业务发展规划的顺利实施以及持续的行业前沿技术研发布局，促进公司可持续发展。

##### （2）公司业务规模快速扩张，对流动资金需求增加

近年来，公司维持着较高的业务规模增速，日常运营对流动资金要求较高。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司营业收入分别为 103,373.62 万元、117,378.39 万元、132,712.94 万元，公司 2023-2025 年营业收入年均复合增长率达 13.31%。结合公司持续增长的销售收入、不断扩大的业务规模，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，对流动资金的需求也将进一步扩大。本次补充流动资金将有助于增强公司资金实力，对实现可持续发展具有重要意义。

### 3、项目实施的可行性分析

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，具有可行性。公司已建立完善的企业管理制度，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

## 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目紧跟行业和技术发展趋势。项目顺利实施后，有助于公司把握下游行业发展机遇，满足下游客户日益增长的市场需求，进一步扩大市场份额，有利于公司保持和提高核心竞争力，巩固行业地位，实现公司可持续发展。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，营运资金得到进一步充实，资金实力将明显提升。同时，公司资产负债率将相应下降，资产结构与偿债能力将进一步优化与增强。由于募集资金的使用及募投项目的实施需要一定时间，因此存在净资产收益率、每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。但从长远来看，随着本次募投项目的顺利实施与募集资金的有效使用，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强，最终为投资者带来良好的投资回报，促进公司健康发展。

## 四、本次募集资金投向属于科技创新领域

### （一）本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务

联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具有市场竞争力的大规模集成电路芯片及解决方案。

公司自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产业化，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。同时，公司基于自主的芯片设计研发平台，已形成多款 AIoT 信号处理及传输芯片的产品布局，并实现量产应用。目前公司数据存储主控芯片已经形成覆盖 SATA、PCIe Gen3/Gen4/Gen5 SSD 固态硬盘主控芯片以及 UFS 嵌入式存储主控芯片的产品布局。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的集成电路设计为战略性新兴产业，具体分类为：1 新一代信息技术产业-1.3 新兴软件和新型信息技术服务-1.3.4 新型信息技术服务（6520 集成电路设计），符合科创板行业领域要求；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于新一代信息技术领域企业，符合科创板行业领域要求。本次募集资金将投向面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目，该项目对公司现有及在研产品进行进一步的代际升级，并更加适配终端和云端的存算需求。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，本次募投项目面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

### （二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次募投项目将主要用于巩固公司在数据存储主控芯片领域的核心业务，丰富公司技术储备，提升公司科技创新水平，持续丰富和优化产品线，提升突破关键核心技术的基础和潜力。本次募投项目将为公司从存储主控供应商向存算一体核心芯片厂商的战略升级打下坚实基础。一方面，公司将逐步形成覆盖 SATA、PCIe Gen3-Gen6 全品类 SSD 主控芯片和 UFS 2.2、3.1、4.1、5.0 的产品矩阵，进一步提升在终端消费级领域的市场份额，巩固自身市场地位；另一方面，在企业级领域，公司产品将批量导入下游数据中心及相关生态链客户，进一步拓宽公司成长空间，构筑新的业绩增长极，并促进公司产品结构向更高端、更高附加值产品进行转移，进一步提升公司业绩与品牌价值，推动公司主营业务的持续稳健发展和长远发展战略目标的实现。

此外，通过本次募投项目的实施，公司将推出系列具有全球影响力的固态存储解决方案，全面支撑本土存储模组产品从消费级零售渠道-消费级整机-企业级数据中心应用的市场突破，推动本土存储方案实现从“可用”到“好用”再到“具备全球竞争力”的跨越式升级，筑牢本土存储核心技术底座。

综上所述，本次募投项目将强化公司科创属性，促进公司科技创新水平的持续提升，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况

##### （一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的市场竞争力，助力公司保持长期稳健的经营发展。本次发行不会导致公司的主营业务结构发生重大变化，不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

##### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的注册资本、股本总额等将发生变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续。除此之外，本次发行不会对《公司章程》造成影响。

##### （三）本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

##### （四）本次发行对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成重大影响。截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

##### （五）本次发行对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，系对公司主营业务的进一步拓展和升级，是公司完善产业布局的重要举措。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

## 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

### （一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，营运资金得到进一步充实，资金实力将明显提升。同时，公司资产负债率将相应下降，资产结构与偿债能力将进一步优化与增强，抗风险能力将得到增强，为后续业务扩展提供良好的保障。

### （二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，资产规模也将进一步扩大，由于募集资金的使用及募投项目的实施需要一定时间，存在净资产收益率、每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。

但从长远来看，随着本次募投项目的顺利实施与募集资金的有效使用，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强，有利于公司长期盈利能力的提升。

### （三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入将有所增加。在开始投入募集资金投资项目后，公司经营活动、投资活动产生的现金流出预计也将相应增加，未来随着募集资金投资项目的实施，公司的竞争实力将不断提升，有助于扩大公司经营活动现金流入规模。

## 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成前后，公司均无控股股东。本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形，也不会因本次发行形成同业竞争。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

本次发行将严格按照规定程序由公司董事会、股东会进行审议，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务。

#### **四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

本次发行完成前后，公司均无控股股东。截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情况，亦不存在为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。公司也不会因本次发行而产生资金、资产被实际控制人及其关联人占用以及为其违规提供担保的情况。

#### **五、本次发行对公司负债情况的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率会进一步下降，资产负债结构将更趋合理，抗风险能力将进一步加强。

#### **六、本次股票发行相关风险说明**

##### **（一）本次向特定对象发行股票的相关风险**

##### **1、审批风险**

本次发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东会批准本次发行、上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册等。本次发行能否获得上述审核批准或注册，以及获得相关审核批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

##### **2、发行风险**

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，且最终由公司根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次

发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

### 3、本次发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将相应增加，虽然本次募集资金到位后，公司将高效利用募集资金以提升公司技术能力和长期盈利能力，但受国家宏观经济、行业发展情况、募投项目建设期等因素影响，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，因此本次发行后公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

#### （二）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的 因素

##### 1、业务经营风险

###### （1）产品研发风险

集成电路设计行业具有竞争激烈、研发投入大、不确定性较高、产品更新换代较快的特点。报告期内，公司研发费用分别为 37,971.23 万元、42,518.48 万元和 50,277.02 万元，占营业收入的比例分别为 36.73%、36.22%和 37.88%，占比较高且金额增长较快。数据存储主控芯片涉及领域较多，且每款接口协议的升级迭代速度较快，目前公司数据存储主控芯片已经覆盖 UFS 嵌入式存储和 SSD 主控芯片，覆盖 UFS 3.1、SATA、PCIe Gen3、PCIe Gen4、PCIe Gen5 等接口领域、覆盖消费级、工业级、企业级等应用领域，并计划通过本次发行研发新一代数据存储主控芯片产品。在当前硬件迭代周期持续缩短的背景下，若公司未来未能及时推出适配新技术、新标准的芯片产品，随着行业终端产品全面升级至新标准，公司现有产品虽仍具备一定市场需求，但随着下游应用逐步向新技术、新标准迁移，其销售收入增长空间或将受到制约，市场竞争力亦可能逐步弱化，进而对公司经营业绩的增长性产生不利影响。

###### （2）客户集中度较高的风险

报告期内，公司的芯片产品主要采用直销模式向模组厂商或终端设备厂商销

售产品，受已开发完成的客户持续放量、产品下游应用领域等因素影响，公司存在客户集中度较高的情况。公司的经营业绩与下游模组厂商、终端设备厂商的经营情况相关性较高，如未来该等厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与该等厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

### （3）供应商集中风险

公司为典型的采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 36,452.18 万元、68,080.34 万元和 93,619.35 万元，占各年度采购总额的比例分别为 93.30%、92.06%和 93.26%，供应商较为集中。由于主要供应商集中，如果供应商发展经营不善或与公司合作受限，公司需要短期内找到合适的替代供应商，否则将影响产品的稳定生产。同时，如果未来国际出口管制和贸易摩擦加剧，使得公司相关原材料进口受到限制，影响订单正常履行，也将会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

## 2、财务风险

### （1）存货跌价风险

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 18,259.12 万元、30,894.10 万元和 57,651.85 万元，占流动资产的比例分别为 24.88%、15.90%和 27.03%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新、下游客户采购政策或经营情况发生重大变化导致存货积压，则公司存货可能面临跌价风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## （2）应收账款回收风险

报告期各期末，公司的应收账款账面余额分别为 27,520.93 万元、45,349.76 万元和 31,562.65 万元，占当期营业收入的比例分别为 26.62%、38.64%和 23.78%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险，进而对公司未来业绩、现金流量造成不利影响。

## 3、行业及宏观环境风险

### （1）行业竞争风险

目前，数据存储的重要介质—NAND 闪存颗粒主要掌握在三星、海力士、美光等海外厂商中，上述厂商依靠 NAND 闪存颗粒的先发优势、资金实力，可以自主生产数据存储主控芯片，数据存储主控芯片的主要市场份额依旧被海外芯片厂商所垄断，在企业级固态硬盘主控芯片和嵌入式存储主控芯片领域，海外芯片厂商的优势更为明显。同时，数据存储主控芯片在终端产品以及与 NAND 闪存颗粒上的迭代适配需要一定的时间，品牌客户或系统厂商对于芯片供应商的需求存在一定的惯性和时间要求，只有在供应商完成芯片的迭代适配并能稳定供货时，品牌客户才会进行大规模的供应商切换，国内数据存储主控芯片产品的生态系统还在建立中。公司虽然在国内数据存储主控芯片方面市场优势突出，也取得了一定的全球市场影响力，但相较海外芯片厂商还处于劣势地位。如果公司对未来市场动态和行业发展趋势出现误判，开发的芯片产品不符合市场需求或错失市场窗口，将会出现公司行业地位和市场份额受到冲击的情况。

### （2）国际出口管制和贸易摩擦风险

近年来，国际贸易中部分国家针对半导体设备领域颁布了一系列对中国的出口管制政策，同时，陆续将多家中国半导体企业纳入“实体清单”（Entity List）和“未经核实清单”（Unverified List），限制其采购受《出口管制条例》管辖的物品。

随着全球主要经济体经济增速持续放缓，贸易保护主义及国际经贸摩擦的风险仍将存在，不能排除国际贸易政策未来变化会对国内芯片设计企业带来一定的限制和不利影响，从而影响本土半导体产业链完整、持续、稳定的发展。随着相关事态的发展，贸易政策发生不利变化，公司可能面临相关订单减少的局面，进而对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

### **（三）募集资金投资项目实施风险**

公司已结合当前行业发展情况、公司发展战略等因素对募集资金投资项目进行了审慎、充分的调研、论证和可行性分析，但本次募集资金投资项目投入较大、实施期较长，期间若宏观政策环境、行业竞争情况、技术水平、下游需求等因素发生不利变化可能会对募集资金投资项目的实施产生较大影响，导致募投项目的实施效果不及预期，进而对公司业绩产生不利影响。

### **（四）股票价格波动风险**

本次发行后，公司的股票价格不仅受到财务状况、经营业绩和未来发展前景等内在因素的影响，还会受到国内外政治经济局势、资金供求关系、投资者心理变化等多种外部因素的影响。公司股票价格可能产生较大扰动并背离投资价值，从而使投资者面临投资损失的风险。因此，投资者应清醒认知资本市场投资收益与风险并存的特点，充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

## 第四节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司利润分配政策

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求以及《公司章程》的规定，公司现行利润分配政策如下：

#### （一）利润分配政策

##### 1、利润分配原则

公司实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。在决策和论证过程中应当充分听取和考虑独立董事和中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### 2、利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

##### 3、利润分配的条件及比例

在满足下列条件时，应当进行分红：

（1）在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司

股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

#### 4、现金分红的期间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

#### 5、股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### 6、公司的差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照

前项规定处理。

重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## （二）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （三）公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照第（二）款的规定履行相应决策程序。

## 二、公司最近三年股利分配情况

公司于 2024 年 11 月完成首次公开发行股票，公司最近三年现金股利分配具体情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额（含税）	归属于上市公司 股东的净利润	现金分红占归属于上市公司 股东净利润的比例
2023 年度	-	5,222.96	-
2024 年度	-	11,805.86	-
2025 年度	2,300.00	14,215.85	16.18%
最近三年累计现金分红金额			2,300.00
最近三年归属于母公司股东年均可分配利润			10,414.89
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			22.08%

注：2025 年度现金分红方案已于 2026 年 4 月 9 日经公司董事会审议，尚需提交公司年度股东会审议。

近年来公司业务快速发展，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和增强抵御风险的能力，公司 2023 年度和 2024 年度未进行股利分配，2025 年度拟实施现金分红。2025 年度，公司综合考虑所处发展阶段、未来资金需求等因素后拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 2,300 万元（含税）。

## 三、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司滚存未分配利润主要用于补充业务发展所需流动资金及研发项目投入，以支持公司业务发展及发展战略的落实。

## 四、公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

为完善和健全联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的规定，并结合《公司章程》，公司制订了《分红回报规划》，主要内容如下：

## 一、《分红回报规划》制定的原则

公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

## 二、《分红回报规划》制定的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

## 三、未来三年（2026 年-2028 年）具体分红回报规划

### （一）利润分配原则

公司实施稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。在决策和论证过程中应当充分听取和考虑独立董事和中小股东的意见。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### （二）利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司在选择利润分配方式时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄情况等真实合理因素。

### （三）利润分配的条件及比例

在满足下列条件时，应当进行分红：

1、在公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于

当年实现的可供股东分配的利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

#### （四）现金分红的期间间隔

在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（五）股票股利分配的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

#### （六）公司的差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### 四、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

#### 五、股东回报规划制定周期及调整机制

（一）公司原则上应以三年为一个周期，根据法律法规、规范性文件及监管机构的要求，并综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等因素，制定股东回报规划。

（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对股东分红回报规划进行调整，但调整后的股东分红回报规划不得违反相关法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

公司修改股东分红回报规划时，应经过详细论证，经董事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议修改股东分红回报规划和利润分配相关政策时，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

## 六、其他事项

《分红回报规划》未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。《分红回报规划》由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。

## 第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺

### 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

#### （一）主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务数据的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2026 年 10 月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额上限为 206,167.60 万元（含本数），不考虑发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，即发行 46,000,000 股（含本数）。前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权、中国证监会及上交所相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐人（主承销商）协商确定。

5、在预测公司总股本时，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 460,000,000 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等）对公司股本总额的影响。

6、根据《联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年年度报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 14,215.85 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,154.78 万元。

7、假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比 2025 年度存在增加 20%、保持不变、减少 20% 三种情形。

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。未考虑股利分配、不可抗力因素、限制性股票授予等对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。

上述假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体测算结果如下：

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	46,000.00	46,000.00	50,600.00
<b>假设 1：2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度分别增长 20%</b>			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,215.85	17,059.02	17,059.02
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,154.78	12,185.74	12,185.74
基本每股收益（元/股）	0.31	0.37	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.37	0.36
扣除非经常性损益后基本每股	0.22	0.26	0.26

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
收益（元/股）			
扣除非经常性损益后稀释每股 收益（元/股）	0.22	0.26	0.26
<b>假设 2：2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度保持不变</b>			
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	14,215.85	14,215.85	14,215.85
扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润（万元）	10,154.78	10,154.78	10,154.78
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.30
扣除非经常性损益后基本每股 收益（元/股）	0.22	0.22	0.22
扣除非经常性损益后稀释每股 收益（元/股）	0.22	0.22	0.22
<b>假设 3：2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年度分别减少 20%</b>			
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	14,215.85	11,372.68	11,372.68
扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润（万元）	10,154.78	8,123.83	8,123.83
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	0.24
扣除非经常性损益后基本每股 收益（元/股）	0.22	0.18	0.17
扣除非经常性损益后稀释每股 收益（元/股）	0.22	0.18	0.17

注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算得出。

## 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将相应增加，虽然本次募集资金到位后，公司将高效利用募集资金以提升公司技术能力和长期盈利能力，但受国家宏观经济、行业发展情况、募投项目建设期等因素影响，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，因此本次发行后公司股东即期回

报存在被摊薄的风险。

公司盈利水平假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺。此外，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

### 三、本次发行的必要性和合理性

关于本次发行的必要性和合理性详见本预案之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

### 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

#### （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募投项目包括面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目及补充流动资金。上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开，顺应行业市场发展方向，符合公司业务布局及未来发展战略。

其中，面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目是公司顺应存储行业技术发展趋势、响应下游市场需求而做出的重要布局，将进一步巩固公司在数据存储主控芯片领域的业务优势，持续丰富和优化产品线，提升公司科技创新水平，增强公司核心竞争力，为公司从存储主控供应商向存算一体核心芯片厂商的战略升级打下坚实基础。

补充流动资金则可使公司充分利用资本市场优势，增强自身资金实力，满足公司日益增长的经营性现金流需要，优化资产负债结构，提高抗风险能力，增强核心竞争力和盈利能力，促进公司业务稳步发展。

## （二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### 1、人员储备

公司高度重视集成电路芯片领域设计及研发管理人才的培养，积极引进行业资深人才，已经建立了一支经验丰富、底蕴深厚的人才团队，具备丰富的研发经验和前瞻的战略眼光。公司的市场、运营等部门的核心团队均拥有行业内知名公司多年的工作经历，具有丰富的产业经验和专业的管理能力。同时公司不断完善员工激励体系，进一步增强员工的归属感和团队凝聚力，有效激发了业务骨干的积极性，并持续吸引优质人才的加入。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员共有 659 名，占公司员工总数的 83.74%。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，是奠定公司技术实力的基石，保障了公司产品的市场竞争力。

未来，公司拟进一步加大研发投入，持续引入高层次人才并强化自主培养体系，不断扩充公司研发团队规模，进一步提升研发团队综合能力与水平，为公司本次募集资金投资项目储备充足的人才。

### 2、技术储备

公司建立了以研发平台为核心的多部门协调参与的研发体系，构建起围绕 SoC 芯片设计平台的技术研发、中后端设计服务、芯片验证等多环节研发体系。公司基于多年对电路设计、工艺制造、封装测试等环节从业经历与经验，针对不同产品线技术及市场发展特点，构建可共享、可复用的 IP 及 SoC 架构设计技术，最大限度地降低研发成本，实现了研发资源的高效共享，缩短产品从设计到量产的研发周期。公司根据不同产品线技术特点，通过大量数据分析及模拟验证，总结出不同产品线产品设计的技术要点，建立针对不同产品线可共享复用的设计 IP 模块，为后续跨产品线芯片产品快速量产和演进打下坚实基础。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 102 项授权发明专利、29 项集成电路布图设计专有权和 69 项计算机软件著作权。强大的研发能力和丰富的技术积累使

公司具备了较强的技术竞争优势，进一步提高了公司核心技术优势和产品竞争力，为募集资金投资项目的成功实施提供了有力的技术保障。

### 3、市场储备

公司深耕存储主控芯片领域，凭借过硬的产品品质、良好的客户口碑和企业声誉，公司产品在业内获得了广泛认可，与客户 A、江波龙、客户 B、佰维存储、德明利、时创意、怡亚通、威刚等知名企业建立了密切的合作关系。公司固态硬盘主控芯片搭载全球七大 NAND Flash 原厂颗粒不同的固态硬盘解决方案，已广泛应用于江波龙（雷克沙、FORESEE）、致态（钛）、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维、七彩虹、光威、台电、铭瑄、金泰克、京东京造麒麟、爱国者、朗科等品牌的 SSD 产品。

未来公司将继续保持与下游客户深入稳定的合作，持续提供高性能的主控芯片产品，为公司业务持续增长以及募集资金投资项目的顺利实施奠定坚实基础。

综上，公司在人员、技术和客户等方面具有丰富的储备，能够为本次募集资金投资项目的实施提供有力保障。

## 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司拟采取的具体措施如下：

### （一）持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，并根据《公司章程》不断完善公司治理结构，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益；公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提高经营和管理效率，控制经营和管理风险；同时，公司将努力提高资金的使用效率，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控风险，保

障公司持续、稳定、健康发展。

## （二）积极推进募投项目实施，提升资金使用效率

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景。通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升核心竞争力，持续推动主营业务的良好发展。本次发行募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，加快推进募投项目实施，增强未来的股东回报。

## （三）加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

本次发行募集资金到位后，公司将严格执行相关监管规定及《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金使用，保证募集资金在合法合规的基础上，充分有效利用。同时为保障公司规范、有效使用募集资金，公司董事会将持续对募集资金的存放、管理和使用情况进行监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## （四）完善利润分配政策，优化投资回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司制订了《联芸科技（杭州）股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，重视股东的合理投资回报。本次发行完成后，公司将严格执行利润分配相关规定，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，促进对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的权益。

## 六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为保障中小投资者利益，确保本次向特定对象发行股票摊薄即期回报风险的填补措施得到有效执行，公司实际控制人、董事、高级管理人员作出如下承诺：

### （一）实际控制人承诺

公司实际控制人方小玲承诺如下：

- “1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
- 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将按照相关规定在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会、上海证券交易所按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。”

### （二）董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

- “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人承诺严格遵守及执行公司相关制度及规定，对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会薪酬与

考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司后续推出股权激励计划，本人承诺在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将按照相关规定在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会、上海证券交易所按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的相关处罚或采取的相关监管措施；对公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。”

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日